レジュメ（経歴及び今後の活動内容）

提出者氏名：

専門分類（業務経験上で特に専門とされる分類にチェックを入れて下さい）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大分類** | 半導体プロセス | サブストレート | | プリント配線板（ﾘｼﾞｯﾄﾞ/フレキ） | |
| 設計 | 製造 | 実装 | | 品質管理 |
| 経営 | 営業 | 調達 | | 工場設営 |
| **小分類** | 設計：部品データ設計（基板構造含む）配線設計　CAM出力　シミュレーション　その他  製造：資機材（材料、薬剤、装置等）TH加工（穴あけ、めっき等）表面処理（OSP、  金めっき等）製造技術（積層プレス、パターン形成、ソルダレジスト等）生産技術　その他  実装：電子部品　搭載・接合技術　その他  品質管理：検査技術　信頼性評価技術　各種解析技術　問題解決手法  品質管理手法　クレーム対策技術　その他  半導体プロセス：前工程　後工程　その他  経営：経営管理　生産管理　情報システム　その他  営業：マーケティング　技術営業　その他  調達：設備調達　材料・部品調達　その他  工場設営：基板製造装置設計　設備仕様設計　その他  その他（　　　　　） | | | | |

経歴の補足説明

1. これまで経験した業務の中で、自身が一番貢献できたもの

２．現在取り組んでいる課題

３．後進（部下及び後輩）の指導をどのようにしているか

**注意事項**

・経歴の補足として1～3の設問においてご記入下さい。

・今後の活動内容についてA4サイズ1枚以内でご記入下さい。

（★この注意項目は、レジュメ作成時に除去して下さい。）

経歴の補足説明

今後の活動計画について